

Zestaw do łączenia obudów



Mi WD 2

- Zestaw do łączenia obudów
- do ścian obudowy 150/300 mm

- do łączenia obudów Mi
- składa się z 1 uszczelki, 4 połączeń klinowych, 1 klamry

Masa

0,053 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

